

部品内蔵基板パッケージにおける熱応力発生要因に関する研究

松浦, 政光

<https://hdl.handle.net/2324/7157363>

出版情報 : Kyushu University, 2023, 博士 (工学), 課程博士
バージョン :
権利関係 :

| | | | | |
|--------|------------------------------|------|----|-------|
| 氏 名 | 松浦 政光 | | | |
| 論 文 名 | 部品内蔵基板パッケージにおける熱応力発生要因に関する研究 | | | |
| 論文調査委員 | 主 査 | 九州大学 | 教授 | 木村 俊二 |
| | 副 査 | 九州大学 | 教授 | 加藤 和利 |
| | 副 査 | 九州大学 | 教授 | 金谷 晴一 |

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本研究は、一度埋め込んだ半導体チップに対して、チップ裏面の埋め込み樹脂の除去と、キャビティを有したプリプレグを用いることで、世界で初めて中空構造を有する部品内蔵基板を開発し、その部品内蔵基板を用いて、基板内に発生する熱応力の発生要因を特定したものであり、電気電子工学上価値のある業績である。よって博士（工学）の学位に値すると認める。